



ЭТИКЕТКА

Микросхема ОС80БУИЗ

Микросхема типа ОС805УИЗ соответствует техническим условиям ОК0.347.005 СЧТУ

Функциональное назначение

ОС80БУИЗ - усилитель считывания

Режим работы

Напряжение питания Е, В + 5 ± 10%; минус 2,4 ± 10%
 Ток потребления I пот, мА, не более 12,0; 8,0

Основные электрические параметры микросхемы при температуре + 25 ± 10°C

Верхний уровень выходного сигнала U вг, В, не менее 3,0

Нижний уровень выходного сигнала U нг, В, не более 0,25

Длительность выходного сигнала Tиг, мкс, не менее 0,25

Частота следования сигнала Fу, кГц, не более 125

Порог срабатывания микросхемы ОС80БУИЗ и номиналы выносных резисторов приведены в табл. 7

Таблица 7

Номер партии 986		Номер микросхемы 4				
		Порог срабатывания микросхемы, U пор, мВ				
Напряжение питания, В	EI	E2	Сопротивление между 8 и 10 выводами микросхемы R 6, кОм	Температура окружающей среды, °C		
				+ 25 ± 5	+ 70 ± 3	минус 40 ± 3
+ 4,5	- 2,64		Резистор 0,125 ± 5% ГОСТ 7113 - 71	3,90 2,40 1,80 1,30 0,91 0,68	4,2 5,6 7,6 9,6 12,6 13,4	3,8 5,0 6,2 8,6 11,6 13,6

Номинал сопротивления между выводами 1 и 3 микросхемы R 1 = 1,3 кОм

Содержание драгоценных металлов

"Золото" EUU 30 мг,
 "Серебро" _____ мг

Рекомендации по установке микросхем

При монтаже микросхем не разрешается изгиб выводов ближе 2,0мм от корпуса с радиусом закругления менее 2 мм.
 Микросхему установить без зазора перпендикулярно по отношению к плате.

Пайку выводов микросхем производить на расстояние не менее 1 мм от корпуса паяльником мощностью не более 60 Вт в течение 3-6 с припоя ПОСК 50-18, ПОС 61, ПОССу 61-0,5 ГОСТ 21931-76.

Пайку выводов рекомендуется производить односторонним паяльником:

- температура хала паяльника не более 280°C;
- время касания к каждому выводу не более 3 с;
- интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с;
- расстояние от корпуса до места пайки не менее 1 мм;
- заземление хала паяльника;

Грунтовым паяльником:

- температура расплавленного припоя не более 265°C;
- время воздействия не более 3 с; интервал между повторными пайками одной микросхемы не менее 5 мин;
- расстояние от корпуса до места пайки /по длине вывода/ не менее 1 мм;
- заземление хала паяльника.

Лужение выводов микросхем рекомендуется производить методом погружения в расплавленный припой;

- температура припоя не более 250°C;
- время погружения не более 2 с;
- расстояние от корпуса до зеркала припоя /по длине вывода/ не менее 1 мм;
- допустимое количество погружений одного и того же вывода не более 2;
- интервал между погружениями не менее 5 мин;
- припой и флюс выбираются в соответствии с ОСТ II.029.001-74.

П р и м е ч а н и е: При пайке выводов следует принимать меры, исключающие тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с ОСТ 4Т0.033.000, для влагозащиты применять лак УР-231 ТУ6-10-863-76 или ЭП-730 ГОСТ 20824-75, приклейку производить kleem AK-20 ТУ 6-10-1293-72 и мастикой МИ по ИХО.045.103.

П р и м е ч а н и е: Для очистки плат от флюса после монтажа микросхем, влагозащиты и приклейки микросхем допускается применять любые моющие жидкости, лаки и клей, не оказывающие вредного химического воздействия на покрытие, маркировку, материалы корпусов после согласования с предприятием п/я А-7538 и проведения соответствующих испытаний.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов /в том числе шин "Питание" и "Земля"/ к корпусу и выводам микросхем, не используемых согласно схеме электрической принципиальной.

При ремонте аппаратуры замену микросхем производить только при отключенных источниках питания.
После монтажа микросхемы должны быть защищены в соответствии с руководством по применению бк0.348.010.

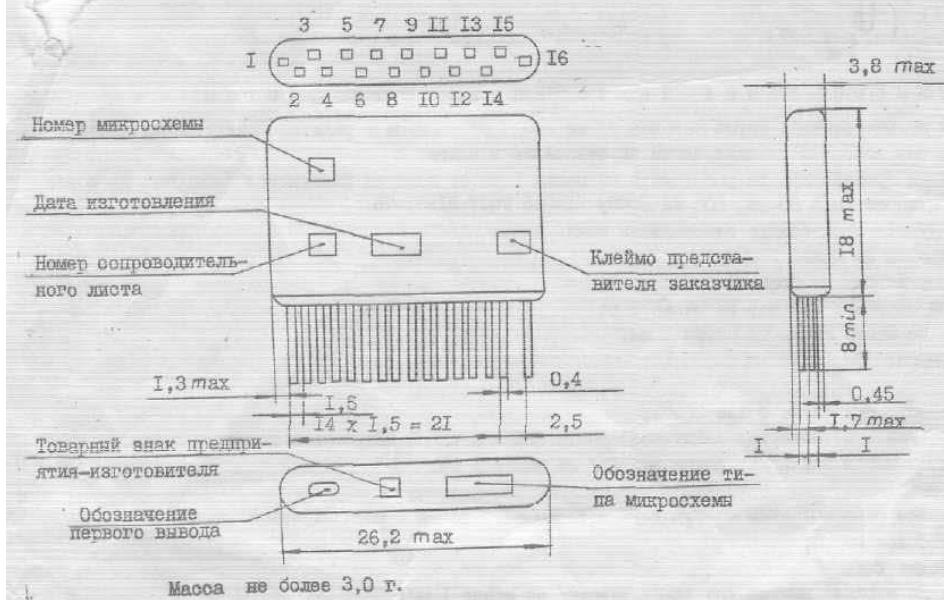
У с л о в и я е к с п л у а т а ц и и

Температура окружющей среды, °С	от минус 10 до + 65
Относительная влажность воздуха при температуре + 40°C, %	98
Атмосферное давление, мм рт.ст.	$1 \cdot 10^{-6}$
Бибрация в диапазоне от 5 до 5000 Гц с ускорением g , до	40
Многократные удары с ускорением g , до	75
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением g , до	150
Одиночные удары с ускорением g , до	150
Время гарантийной наработки 25000 ч.	
Срок хранения 25 лет.	

Г а р а n t i i п r e d p r i i t i a - i z g o t o v i t e l i a

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждой поставленной микросхемы требованиям СОТУ и СЧГУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных настоящим станицартом и СЧГУ. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления напечатанной на микросхеме. Предприятие-изготовитель проводит исследования и анализ причин отказов микросхем, рекламированных потребителем, и доводит результаты рассмотрения до потребителя в соответствии с "Положением о входном контроле..." ред.3-73.

Г а б а r i t n i й ч e r t e j

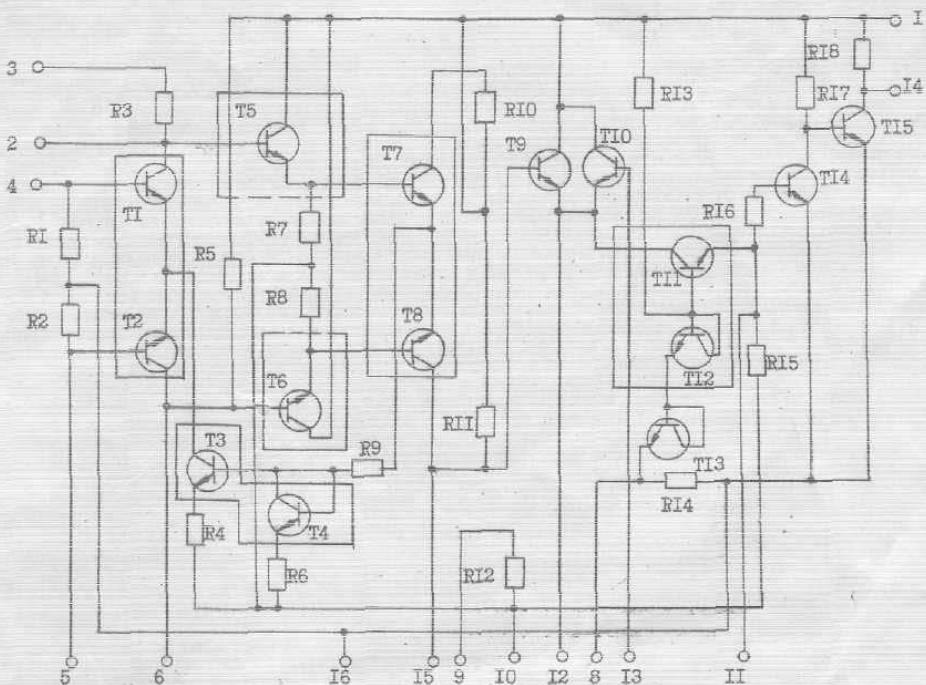


1. Неуказанные предельные отклонения расположения расстояний между первым выводом и любым другим $\pm 0,1$ мм на длине выводов до 0,7 мм от их заливки компаундом.

2. Нумерация выводов показана условно.

3. Допускаются отдельные точечные напльвы припоя на выводах, увеличивающие сечение вывода до $0,5 \times 0,55$ мм.

Схема электрическая принципиальная



R1, R2 - Резисторы 1 кОм ± 10%, 0,15 мВт; R1 = R2 / R2 $\leq 1\%$

R3 - Резистор 10,5 кОм ± 10%, 1,21 мВт

R4 - Резистор 0,5 кОм ± 10%, 0,25 мВт

R5 - Резистор 12 кОм ± 10%, 1,41 мВт

R6 - Резистор 0,3 кОм ± 10%, 0,45 мВт

R7, R8 - Резисторы 3,3 кОм ± 10%, 4,52 мВт; R7 - R8 / R8 $\leq 2\%$

R9 - Резистор 1,5 кОм ± 10%, 1,9 мВт

R10, RII - Резисторы 5,5 кОм ± 10%, 2,4 мВт; R10 - RII / RII $\leq 2\%$

R12 - Резистор 2,4 кОм ± 5%, 3,65 мВт

R13 - Резистор 9 кОм ± 10%, 2,7 мВт

R14 - Резистор 0,2 кОм ± 7%, 0,5 мВт

R15 - Резистор 2,0 кОм ± 10%, 4,0 мВт

R16 - Резистор 0,5 кОм ± 10%, 2,8 мВт

R17 - Резистор 4,7 кОм ± 10%, 7,0 мВт

R18 - Резистор 2,4 кОм ± 10%, 12,1 мВт

T1 - T2 - Микросхема интегральная ОС129НТИ XM3.456.042 СТУ

T5 - T6, T7 - T8 - Микросхема интегральная ОС 129НТИ XM3.456.042 СТУ

T3 - T4, T11 - T12 - Микросхема интегральная ОС129НТИ XM3.456.042 СТУ

T9 - Транзистор С2Т307Г-І СВО.336.026 Д

T10, T13 - Транзистор С2Т307Б-І СВО. 336.026 Д

T14, T15 - Транзистор С2Т307Б-І СВО.336.026 Д

Примечание: Допускается замена:

R2 на R1; R8 на R7; RII на R10; R1 - R2/R2 $\leq 1\%$;

R7 - R8/R8 $\leq 2\%$; R10 - RII / RII $\leq 2\%$;

ОС129НТИ на ОС129НТИ

Схема функциональная

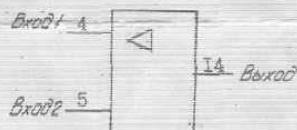


Таблица выводов

№ выводов	Назначение
I	Питание + 5 В
2	Контрольная точка
3	Регулировка
4	Вход 1
5	Вход 2
6	Контрольная точка
8	Регулировка
9	Регулировка
10	Питание - 2,4 В
11	Контрольная точка
12	Контрольная точка
13	Строб запрета
14	Выход
15	Контрольная точка
16	Общий

07.82

10.08.84.

0TH 219

2

Глановщи